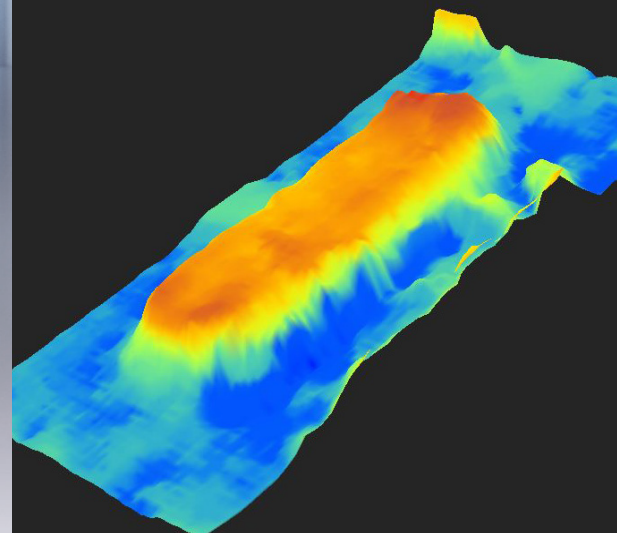




Lotpasten-
inspektionssystem
(SPI) für Inline-
Fertigung



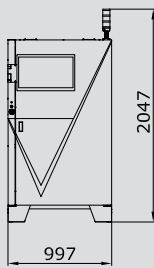
iS6052 SPI

Wirtschaftliche Technologie für zuverlässige
Lot- und Sinterpasteninspektion

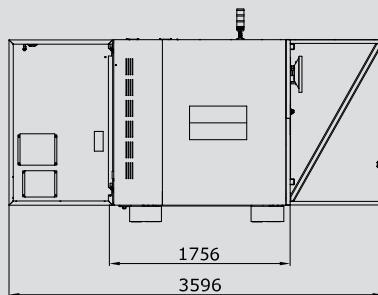


Technische Daten iS6052 SPI

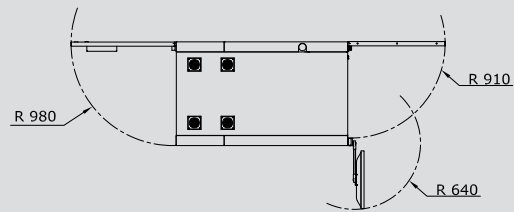
Frontansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Abmessungen in mm

		iS6052 SPI
Prüfumfang		Lotpastendepots (Schablonendruck oder Dispense-Technologie, bis Padgrößen für 01005-Bauteile) Sinterpaste, Klebemittel, Fläche, Höhe, Druckversatz, Verschmierung, Form, Koplanarität Freiflächenanalyse, OCR, DMC
Sensorik		XMe-SPI
	3D-Sensorik	
	Z-Auflösung	0,1 µm
	Z-Messbereich	Bis zu 5 mm
	Schrägansichtskameras	
	Anzahl der Megapixelkameras	4
Orthogonale Kamera		
	Auflösung	12 µm
	Bildfeldgröße	58 mm x 58 mm (2,2" x 2,2")
Prüfgeschwindigkeit		Bis 80 cm ² /s
Software	Bedienoberfläche	Viscom vVision
	Statistische Prozesskontrolle	Viscom vSPC/SPC, offene Schnittstelle (optional)
	Verifikationsplatz	Viscom vVerify/HARAN
	Remote-Diagnose	Viscom SRC (optional)
	Programmierstation	Viscom PST34 (optional)
Systemrechner	Betriebssystem	Windows®
	Prozessor	Intel®Core™i7
Leiterplattenhandling	Leiterplattengröße	508 mm x 508 mm (20" x 20")
	Leiterplattenunterstützung	Optional
	Übergabehöhe	900 - 950 mm ± 20 mm (35,4" - 37,4" ± 0,7")
	Breitenverstellung	Automatisch
	Transportkonzept	Einspur-Transport, Doppelspur-Option verfügbar
	LP-Klemmung	Pneumatisch
	Obere Durchfahrtshöhe	50 mm (1,9")
Untere Durchfahrtshöhe	50 mm (1,9"); 40 mm (1,5") mit Leiterplattenunterstützung	
Sonstige Systemdaten	Verfahreinheit	Synchron-Linearmotor
	Schnittstellen	SMEMA / Hermes
	Anschlusswerte	230/400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10%; 4 - 6 bar Arbeitsdruck
	Systemmaße	997 mm x 1756 mm x 1753 mm (39,2" x 69,1" x 69") (B x T x H)
	Gewicht	Ca. 820 - 920 kg

Spezifikationen und andere Systeminformationen können ohne Ankündigung geändert werden und von den zum Zeitpunkt der Bestellung angezeigten Informationen abweichen.